

吸収分割に関する事前開示書面
(会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に定める書面)

2025 年 11 月 11 日

京セラ株式会社

2025 年 11 月 11 日

吸収分割に関する事前開示事項

京セラ株式会社
代表取締役 谷本 秀夫

京セラ株式会社（以下「分割会社」といいます。）は、2025 年 10 月 31 日に、株式会社秦野パワーデバイス（以下「承継会社」といいます。）との間で吸収分割契約を締結し、2026 年 1 月 5 日を効力発生日として、分割会社が電子部品事業本部電子デバイス事業部で運営するパワー半導体事業を承継会社に承継させる吸収分割（以下「本件分割」といいます。）を行うことを決定いたしました。

本件分割に関する会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に定める事前開示事項は、下記のとおりです。

記

1. 吸収分割契約の内容（会社法第 782 条第 1 項第 2 号）
別紙 1 のとおりです。
2. 会社法第 758 条第 4 号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 1 号イ）
本件分割に際し、承継会社は、分割会社に対し、分割対価である金銭等の交付を一切行いませんが、本件分割の効力発生日において、承継会社は分割会社の完全子会社であることから相当であると判断しています。
3. 会社法第 758 条第 8 号に掲げる事項（会社法施行規則第 183 条第 2 号）
該当事項はありません。
4. 分割会社の新株予約権に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 3 号）
分割会社は会社法第 787 条第 3 項第 2 号に定める新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。
5. 承継会社についての事項（会社法施行規則第 183 条第 4 号）
 - (1) 成立の日における貸借対照表の内容
別紙 2 のとおりです。
 - (2) 成立の日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容

該当事項はありません。

- (3) 成立の日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容

該当事項はありません。

6. 分割会社について最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第183条第5号イ）

該当事項はありません。

7. 吸収分割が効力を生ずる日以後における分割会社及び承継会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第183条第6号）

分割会社及び承継会社のいずれの会社についても、本件分割の効力発生日以後の資産の額が負債の額を上回る見込みであります。

また、本件分割の効力発生日以後の分割会社及び承継会社の資産及び負債の状態について、分割会社の債務及び承継会社の債務の履行に支障を及ぼす事態は、現在のところ予測されておりません。

以上の点、並びに、分割会社及び承継会社の収益状況及びキャッシュフローの状況等に鑑みて、本件分割の効力発生日以後における分割会社の債務及び承継会社の債務（分割会社が本件分割により承継会社に承継させるものに限ります。）の履行の見込みはあるものと考えます。

以 上



別紙1

吸収分割契約書

京セラ株式会社（以下「甲」という。）及び株式会社秦野パワーデバイス（以下「乙」という。）は、以下のとおり、吸収分割契約（以下「**本件吸収分割契約**」という。）を締結する。

第1条 （吸収分割会社・吸収分割承継会社の商号・住所）

本件吸収分割契約に基づく吸収分割（以下「**本件吸収分割**」という。）における吸収分割株式会社及び吸収分割承継株式会社並びにそれらの商号及び住所は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 吸収分割株式会社

甲 商 号 京セラ株式会社

住 所 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地

(2) 吸収分割承継株式会社

乙 商 号 株式会社秦野パワーデバイス

住 所 神奈川県秦野市曾屋 1204 番地

第2条 （吸収分割）

甲は、甲の電子部品事業本部電子デバイス事業部で運営されているパワー半導体事業（以下「**本件承継対象事業**」という。）に属する資産（甲が保有する Kyocera International Electronics Co., Ltd（以下「**KIE**」という。）の発行済株式の全てを含む。）、負債、契約その他の権利義務等のうち本件吸収分割契約において定めるものを、吸収分割の方法により、乙に承継させる。

第3条 （乙に承継する権利義務）

1. 乙は、本件分割効力発生日（第6条にて定義する。以下、本条において同じ。）において、本件吸収分割により、甲から、**別紙**「承継権利義務明細表」記載のとおり資産、負債、契約その他の権利義務等（以下「**本権利義務等**」という。）を承継する。
2. 乙が承継する本権利義務等のうち、負債については、全て甲から乙が免責的に承継する。

第4条 （本件吸収分割に際して対価として交付する金銭等に関する事項）

乙は、本件吸収分割に際して、乙が前条第1項に基づき承継する承継対象権利義務の対価を支払わない。

第5条 （乙の資本金及び準備金等の額に関する事項）

乙は、本件吸収分割により資本金及び準備金の額を増加しない。

第6条 (効力発生日)

本件吸収分割の効力発生日（以下「**本件分割効力発生日**」という。）は、2026年1月5日とする。但し、本件吸収分割の手續進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲と乙の合意によって、これを変更することができる。

第7条 (株主総会による承継)

1. 甲は、会社法第784条第2項の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに本件吸収分割を行う。
2. 乙は、会社法第796条第1項の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに本件吸収分割を行う。

第8条 (競業避止義務)

1. 甲は、本件分割効力発生日から5年間が経過する日までの間、直接又は間接を問わず、乙の書面による事前承諾を得ることなく、本件吸収分割契約締結日において甲の神奈川県秦野工場（曾屋ブロックも含む。以下本条において同じ。）、つくば事業所及びKyocera International Electronics Co., Ltdで運営されているパワー半導体事業と競業し又は競業する可能性のある事業（疑義を避けるために付言すると、①KYOCERA AVX Components Corporationが仕入れ販売しているパワーデバイス事業、②KYOCERA AVX Components CorporationがSalzburgを含むヨーロッパ工場で製造しているパワーモジュール事業及び③GaNデバイス全般に係る事業を除く。以下「**本件競業避止事業**」という。）につき、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとする。
 - (1) 自ら又は自らが直接若しくは間接に株式を保有する会社を通して、あるいは第三者と共同して、本件競業避止事業を行うこと。
 - (2) 本件競業避止事業を行う第三者の株式又はこれに類する権利を取得すること（但し、当該取得の結果、当該第三者が売主グループの子会社又は関連会社となる場合に限る。）、本件競業避止事業に関し第三者との間で業務提携契約等を締結することその他第三者が本件競業避止事業を行うことを支援すること。
2. 甲は、本件分割効力発生日から5年間が経過する日までの間、直接又は間接を問わず、乙の書面による事前承諾を得ることなく、乙の役員及び従業員等（以下「**役職員**」という。）に対し、以下の各号に掲げる行為をしてはならないものとする。但し、これらの役職員が、乙の役職員のみを対象としない一般的な求人広告に、甲又は第三者による直接又は間接の勧誘等なく、自発的に応募した場合を除く。
 - (1) 自ら又は自らが直接若しくは間接に株式を保有し若しくは役員を務める会社その他の第三者の役員、従業員等となることの勧誘を行うこと。
 - (2) 自ら又は自らが直接若しくは間接に株式を保有し若しくは役員を務める会社その他の第三者において就業させること。

第9条 （本件吸収分割の条件変更・中止及び本件吸収分割契約の解除）

本件分割効力発生日までの間に、(i)天災地変その他の事由により、甲の財産若しくは経営状態に重大な変動が生じた場合その他本権利義務に重大な変動が生じたとき、又は(ii)本件吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生じ、若しくは生じることが明らかとなった場合、甲と乙の合意によって、本件吸収分割の条件を変更し、本件吸収分割を中止し、又は本件吸収分割契約を解除することができる。

第10条 （収益及び費用の区分）

本権利義務等に係る収益及び費用は、本件分割効力発生日をもって区分し、本件分割効力発生日の前日（同日を含む。）までの収益及び費用は甲に帰属し、本件分割効力発生日以降の収益及び費用は乙に帰属する。本件分割効力発生日（同日を含む。）において未確定の収益及び費用がある場合、本件分割効力発生日以降、甲と乙との間で別途合意する方法により精算するものとする。

第11条 （規定外事項）

本件吸収分割契約に定める事項の他、本件吸収分割に関し必要な事項は、本件吸収分割契約の趣旨に従って、甲と乙の合意によって決定する。

（以下、余白）

本件吸収分割契約締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が、記名押印の上、各1通を保有する。

2025年10月31日

甲：京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
京セラ株式会社
代表取締役社長 谷本 秀夫



乙：神奈川県秦野市曾屋1204番地
株式会社秦野パワーデバイス
代表取締役社長 松本 学



承継権利義務明細表

乙が甲から承継する資産、負債その他の権利義務は、以下のとおりとする。

なお、承継対象権利義務の詳細については、2025年3月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに本件分割効力発生日に至るまでの増減を加除したものととする。

1. 資産

(1) 流動資産

本件分割効力発生日の前日の終了時点において、本件承継対象事業に属する、棚卸資産、甲のKIEに対する売上債権及び未収入金、本件承継対象事業に関連するその他の流動資産。但し、現金及び預金、上記を除く売上債権及び未収入金、並びに甲のKIEに対する貸付金は除く。

(2) 固定資産

本件分割効力発生日の前日の終了時点において、本件承継対象事業に属する、秦野工場（疑義を避けるために付言すると、曾屋ブロックを含む。以下本別紙において同じ。）及びつくば事業所に所在する以下の各固定資産、本件吸収分割に伴い乙に転籍する甲の従業員（以下「**本転籍従業員**」という。）に関連する前払年金費用並びに甲の保有するKIE株式の一切。但し、甲のKIEに対する貸付金は除く。

① 金型及び工具器具等備品

② 機械装置

③ ソフトウェア

- (3) 本件分割効力発生日の前日の終了時点において、本件承継対象事業に属する、甲の製品、部材等の設計、品質等その他事業に関わる資料及びデータの一切（但し、契約上の秘密保持義務の対象となっている情報であって、甲が当該契約の相手方から当該義務の解除の同意を取得するべく商業上合理的な範囲で最大限努力したにもかかわらず、当該同意を取得することができなかったものを除く。）。

2. 負債

(1) 流動負債

本件分割効力発生日の前日の終了時点において、本件承継対象事業に属する、甲のKIEに対する仕入債務及び未払金、本転籍従業員に関連する人件費債務、本件承継対象事業に関連するその他の流動負債。但し、①上記を除く仕入債務及び未払金、②本転籍従業員に対する支払期日が到来している未払賃金債務そ

の他の未払債務、③本件分割効力発生日前の事由に起因する損害賠償債務、不法行為債務、潜在債務、偶発債務及び簿外債務（本件分割効力発生日前の事由に起因して本件分割効力発生日以後に発生する債務を含み、債務の存在を甲が本件分割効力発生日時点で認識していたか否かを問わない。また、金銭支払債務か否かを問わない。）は除く。

(2) 固定負債

本件分割効力発生日の前日の終了時点において、本件承継対象事業に属する、本転籍従業員に関連する退職給付引当金、本件承継対象事業に関連するその他の固定負債。但し、①つくば事業所の土壌汚染に係る浄化費用、②本転籍従業員に対する支払期日が到来している未払賃金債務その他の未払債務、③本件分割効力発生日前の事由に起因する損害賠償債務、不法行為債務、潜在債務、偶発債務及び簿外債務（本件分割効力発生日前の事由に起因して本件分割効力発生日以後に発生する債務を含み、債務の存在を甲が本件分割効力発生日時点で認識していたか否かを問わない。また、金銭支払債務か否かを問わない。）は除く。

3. 知的財産権

別添 3 に掲げる各特許権及び商標権。

4. 契約上の地位

本件承継対象事業に係る別添 4 記載の契約、及び、以下の各号に掲げる契約（但し、甲の他の事業と共用されている契約並びに本件承継対象事業に係る販売先及び仕入先との各契約を除く。）に係る契約上の地位及びこれに基づく一切の権利義務（但し、当該契約に基づき、本件分割効力発生日の前日の終了時点において既に発生している金銭債権及び金銭債務の取扱い、並びに、上記時点より前に生じた事由に起因して、当該時点以降に発生する損害賠償債務、不法行為債務、潜在債務、偶発債務及び簿外債務の取扱いは上記第 1 項及び第 2 項による。）。

- (1) 本件承継対象事業に係る製商品の秦野工場及びつくば事業所から各仕向地への輸送等に係る物流業務委託に係る契約
- (2) 秦野工場及びつくば事業所における工場操業に係る電気・水道・ガス等（室素は除く）の光熱費に係る契約
- (3) 本件承継対象事業に関して加入している自治会、工業会等への加入に係る契約
- (4) 本件承継対象事業に従事する従業員が秦野工場及びつくば事業所において着用する、防塵服等の衣服のクリーニングに係る契約
- (5) 秦野工場及びつくば事業所において排出等される産業廃棄物の処理に係る契約
- (6) 本件承継対象事業に従事する従業員の寮・社宅に関する、賃貸借契約、光熱費に係る契約その他の契約
- (7) その他上記各号に準ずる契約であって、乙が本件分割効力発生日時点と実質的

に同様の態様にて本件承継対象事業の継続を行うために必要な契約

5. **雇用契約**

該当なし

6. **許認可**

該当なし

別添 3

承継対象物の財産権

No.	特許番号	発明の名称 (特許)	国コード	出願番号	公開/(西)公表番号	公開/(西)公表日	登録番号	登録日
1	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2006-273251	2008-091787	2008/4/17	4628337	2010/11/19
2	特許	パワー半導体モジュールの製造方法	JP/日本	2008-119373	2009-272351	2009/11/19	5252626	2013/4/26
3	特許	パワー半導体モジュールの製造方法	JP/日本	2009-147523	2011-003832	2011/1/6	5252650	2013/4/26
4	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2009-204927	2011-054896	2011/3/17	5283277	2013/6/7
5	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2009-257649	2011-103369	2011/5/26	5341718	2013/8/16
6	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2009-261868	2011-108817	2011/6/2	5295933	2013/6/21
7	特許	ショットキーバリアダイオード	JP/日本	2009-287352	2011-129738	2011/6/30	5149266	2012/12/7
8	特許	半導体装置	JP/日本	2010-252768	2012-104696	2012/5/31	5755867	2015/6/5
9	特許	圧接型大電力用サイリスタモジュールおよびその製造方法ならびにその使用方法	JP/日本	2011-135027	2013-004774	2013/1/7	5674563	2015/1/9
10	特許	端子曲げ加工装置および半導体装置	JP/日本	2011-231231	2013-086161	2013/5/13	5845052	2015/11/27
11	特許	樹脂封止型パワー半導体モジュール及びその製造方法	JP/日本	2011-279188	2013-131590	2013/7/4	5711136	2015/7/3
12	特許	樹脂封止型パワー半導体モジュール及びその製造方法	JP/日本	2011-282770	2013-135019	2013/7/8	5845085	2015/11/27
13	特許	ダイオード及び半導体モジュール及び電源回路	JP/日本	2012-006157	2013-145831	2013/7/25	5993150	2016/8/26
14	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2012-110138	2013-239501	2013/11/28	5921949	2016/4/22
15	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2012-175515	2014-036065	2014/2/24	5973833	2016/7/22
16	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2012-254815	2014-103284	2014/6/5	5986488	2016/8/12
17	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2013-010397	2014-143282	2014/8/7	61122645	2017/4/7
18	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2013-048326	2014-175545	2014/9/22	6071662	2017/1/13
19	特許	圧接型電力用半導体装置	JP/日本	2013-077405	2014-203903	2014/10/27	6233794	2017/11/2
20	特許	パワー半導体モジュールおよびその製造方法	JP/日本	2013-129060	2015-005580	2015/1/8	6148549	2017/5/26
21	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2013-175020	2015-043396	2015/3/5	6139332	2017/5/12
22	特許	電気回路基板及び電気回路基板の製造方法	JP/日本	2013-268183	2015-126039	2015/7/6	6342157	2018/5/25
23	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2014-096443	2015-216148	2015/12/3	6246654	2017/11/24
24	特許	半田塗布装置	JP/日本	2014-116694	2015-230973	2015/12/21	6294163	2018/2/23
25	特許	電力変換装置	JP/日本	2014-140175	2016-019346	2016/2/1	6327983	2018/4/27
26	特許	コンデンサモジュール及びパワーユニット	JP/日本	2014-182019	2016-059120	2016/4/21	6383614	2018/8/10
27	特許	パワーモジュール及びパワーユニット	JP/日本	2014-211621	2016-082056	2016/5/16	6537246	2019/6/14
28	特許	半導体装置	JP/日本	2015-060470	2016-181581	2016/10/13	6185504	2017/8/4
29	特許	パワー半導体モジュールの製造方法及びパワー半導体モジュール	JP/日本	2015-165092	2017-045771	2017/3/2	6462529	2019/1/11
30	特許	パワー半導体モジュール及びその製造方法	JP/日本	2015-165093	2017-045772	2017/3/2	6498566	2019/3/22
31	特許	パワー半導体モジュールの製造方法	JP/日本	2015-221894	2017-092293	2017/5/25	6567957	2019/8/9
32	特許	半導体装置	JP/日本	2016-005761	2017-126682	2017/7/20	6523976	2019/5/10
33	特許	半導体装置	JP/日本	2016-033106	2017-152525	2017/8/31	6600263	2019/10/11
34	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2016-048870	2017-163113	2017/9/14	6567996	2019/8/9
35	特許	パワー半導体モジュール及びその製造方法	JP/日本	2017-105227	2018-200963	2018/12/20	7005174	2022/1/7
36	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2018-013181	2019-134006	2019/8/8	7050504	2022/3/31
37	特許	パワー半導体モジュール	US/アメリカ	17/055699	2021/0210421	2021/7/8	11626361	2023/4/11
38	特許	パワー半導体モジュール	JP/日本	2018-050582	2019-165051	2019/9/26	6924716	2021/8/4
39	特許	半導体デバイス及び電気装置	CN/中国	201980041794.7	112352319	2021/2/9	ZL201980041794.7	2023/10/10
40	特許	半導体デバイス及び電気装置	EP/EP	19826828.6	3817069	2021/5/5		
41	特許	半導体デバイス及び電気装置	JP/日本	2018-124659	2020-004906	2020/1/9	6626929	2019/12/6
42	特許	半導体デバイス及び電気装置	US/アメリカ	17/253970	2021/026511	2021/8/26	11393933	2022/7/19
43	特許	パワーモジュール及びパワーモジュールを有する電気装置	JP/日本	2018-183616	2020-053622	2020/4/2	7034043	2022/3/3
44	特許	パワーユニット、パワーユニットの製造方法及びパワーユニットを有する電気装置	JP/日本	2018-183625	2020-053623	2020/4/2	7118839	2022/8/5
45	特許	タンデムダイオード、電気回路及び電気装置	CN/中国	201980083380.0	113196502	2021/7/30	ZL201980083380.0	2024/11/19
46	特許	タンデムダイオード、電気回路及び電気装置	JP/日本	2020-563230	WO2020/137931	2021/1/18	7534223	2024/8/5
47	特許	電気回路及び電気装置	CN/中国	201980083462.5	113169224	2021/7/23	ZL201980083462.5	2024/7/23
48	特許	電気回路及び電気装置	JP/日本	2020-563232	WO2020/137933	2021/1/11	7456940	2024/3/18
49	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	CN/中国	202080016686.7	113544818	2021/10/22	ZL202080016686.7	2024/5/24
50	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	JP/日本	2021-504066			7483675	2024/5/7
51	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	KR/韓国	10-2021-7026473	10-2021-0115031	2021/9/24	10-2622892	2024/1/4
52	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	US/アメリカ	17/434034	2022/0139780	2022/5/5		
53	特許	パワーモジュール及びその製造方法	JP/日本	2019-140538	2021-027055	2021/2/22	7267869	2023/4/24
54	特許	整流装置及び電圧電圧保護システム	JP/日本	2019-212363	2021-084448	2021/6/3	7326129	2023/8/4
55	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	JP/日本	2020-053560	2021-153155	2021/9/30	7431079	2024/2/5
56	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	CN/中国	202180020185.0	115280516	2022/1/11	ZL202180020185.0	2024/10/25
57	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	EP/EP	21792024.8	4141962	2023/3/1		
58	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	JP/日本	2022-517093			7630500	2025/2/6
59	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	US/アメリカ	17/910046	2023/0101385	2023/3/30	12382646	2025/8/5
60	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	JP/日本	2022-511898			7727621	2025/8/13
61	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	US/アメリカ	17/911929	2023/0137811	2023/5/4	12389614	2025/8/12
62	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	EP/EP	21793142.7	4141963	2023/3/1		
63	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	JP/日本	2022-517095			7697932	2025/6/16
64	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	KR/韓国	10-2022-7031038	10-2022-0137747	2022/10/12	10-2836287	2025/7/16
65	特許	半導体装置及び半導体装置の製造方法	US/アメリカ	17/920221	2023/0178663	2023/6/8	12382647	2025/8/5
66	特許	半導体装置及び電子機器	JP/日本	2022-094922	2023-181665	2023/12/25		
67	特許	半導体ダイオード装置及びその製造方法	WO/WIPO	PCT/JP2025/016791				
68	商標		JP/日本	昭63-035601			2381043	1992/2/28
69	商標		JP/日本	昭63-035602			2402353	1992/4/30
70	商標		JP/日本	平04-330644			3114093	1996/1/31
71	商標		JP/日本	2009-012800		2009/3/19	5299510	2010/2/5
72	商標		JP/日本	2012-071528		2012/9/27	5556752	2013/2/8
73	商標		TW/台湾	89047794			00984414	2002/2/16
74	商標		TW/台湾	89047795			00984415	2002/2/16
75	商標		TW/台湾	77035796			00495301	1990/8/16
76	商標		TW/台湾	77035797			00495302	1990/8/16
77	商標		KR/韓国	1988-0021239			190359	1990/4/12
78	商標		KR/韓国	1988-0021239			190360	1990/4/12
79	商標		GB/イギリス	1358453			81358453	1991/5/24
80	商標		US/アメリカ	73755925			1797559	1993/10/12
81	商標		DE/ドイツ				1154612	1990/2/20
82	商標		CN/中国	20160000135329			923257	1996/12/27
83	商標		SG/シンガポール				197/078638	1997/7/3
84	商標		HK/香港				302367298	2012/9/4
85	商標		HK/香港				302367289	2012/9/4

別添 4

承継対象契約

NO.	契約先	契約書名
1	住友三井オートサービス	自動車リース契約書
2	住友三井オートサービス	自動車リース契約書
3	東京センチュリー	リース契約書（複合機）
4	東京センチュリー	リース契約書（複合機）
5	トヨタレンタリース京都	自動車リース契約書
6	トヨタレンタリース京都	自動車リース契約書
7	リコーリース株式会社	リース契約書（複合機）
8	リコーリース株式会社	リース契約書（複合機）
9	リコーリース株式会社	リース契約書（複合機）
10	リコーリース株式会社	リース契約書（複合機）
11	株式会社ツクバ計画	植栽管理業務・清掃管理業務委託契約書
12	FVイーストジャパン株式会社	機材貸与契約書
13	株式会社トヨタレンタリース京都	自動車リース契約書
14	ソフトバンク株式会社	携帯電話無線基地局設備利用申込書
15	総合警備保障株式会社	警備業務請負契約書
16	株式会社サニクリーン東京	レンタルマット
17	リコーリース株式会社 神奈川支社	リース契約確認書
18	リコーリース株式会社 神奈川支社	リース契約確認書
19	株式会社スワベ商会	リース契約書（複合機）
20	東京ガスファシリティサービス(株)	施設管理業務委託契約書
21	株式会社富士産業	業務委託契約書
22	秦野シルバー人材センター	請負契約書・覚書
23	アマノ株式会社	ATMSソフトウェア/ハードウェア保守契約
24	株式会社ユニマットライフ	レンタル契約書
25	東京センチュリー	リース契約書（複合機）
26	日本カルミック	レンタルサービス契約書
27	ALSOK神奈川(株)	常駐警備業務請負契約書
28	総合警備保障(株)	警備請負契約書
29	総合警備保障(株)	警備請負契約書
30	総合警備保障(株)	請書
31	三菱オートリース株式会社	フォークリフトリース契約書
32	リコーリース株式会社	リース契約
33	KK 初サシアー	賃貸借契約書
34	トヨタレンタリース 神奈川	産業車両リース契約書
35	トヨタレンタリース 神奈川	自動車リース契約
36	トヨタレンタリース 神奈川	産業車両リース契約書
37	株式会社富士産業	業務委託契約書
38	トヨタレンタリース京都	自動車リース契約書
39	東京センチュリー	複合機リース
40	東京電力エナジーパートナー(株)	電気需給契約書
41	東京電力エナジーパートナー(株)	追加契約
42	東京電力エナジーパートナー(株)	デマンドレスポンス契約(SR)

43	東京電力エナジーパートナー(株)	電気需給契約書
44	東京電力エナジーパートナー(株)	電気需給契約書
45	東京電力エナジーパートナー(株)	お客さま番号06819-04183-9-00
46	東京電力エナジーパートナー(株)	お客さま番号26003-20023-0-00
47	秦野ガス(株)	ガス需給契約書(業務用E契約)
48	秦野ガス(株)	一般契約(都市ガス)(0113-1204-9903)
49	秦野ガス(株)	一般契約(都市ガス)(神奈川秦野工場0113-1204-9903)
50	秦野ガス(株)	プロパンガス(2113-1204-0002)
51	秦野ガス(株)	プロパンガス(2113-0550-0000)
52	ALSOK神奈川(株)	常駐警備業務請負契約書
53	総合警備保障(株)	警備請負契約書
54	総合警備保障(株)	警備請負契約書
55	総合警備保障(株)	請書
56	(株)富士産業	工場付属設備等運転委託契約書
57	三菱電機ビルソリューションズ	8号棟エレベーター点検
58	中央エレベーター	点検契約書
59	日本カーソリユーション	日産 ADバン
60	トヨタレンタリース神奈川	トヨタ ダイナ
61	個人：医師 永島	産業医委嘱契約書
62	(株)イイダ	産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬・処理)
63	SNKテクノ(株)	産業廃棄物処理委託契約書(処理)
64	松田産業(株)	産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬：S N K用)
65	セントラル総合サービス(株)	産業廃棄物処理委託契約書(処理)
66	(株)イイダ	産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬：セントラル用)
67	鶴見油化工業(株)	産業廃棄物処理委託契約書(処理)
68	(株)イイダ	産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬：鶴見油化用)
69	J&T環境(株)	産業廃棄物処理委託契約書(処理)
70	(株)イイダ	産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬：J & T用)
71	日曹金属化学(株)	産業廃棄物処理委託契約書(処理)
72	松田産業(株)	産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬：日曹金属化学用)
73	秦野金属(株)	産業廃棄物処理委託契約書(処理)
74	近藤産興(株)	産業廃棄物処理委託契約書(処理)
75	松田産業(株)	産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬)
76	(株)クレハ環境	産業廃棄物処理委託契約書(処理)
77	松田産業(株)	産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬：クレハ用)
78	鶴見油化工業(株)	産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書
79	(株)イイダ	一般廃棄物処理委託契約書
80	(株)イイダ	廃棄文書リサイクル処理委託に関する契約書
81	(株)イイダ	売買基本契約書
82	秦野金属(株)	再生用古紙の収集運搬に関する業務委託契約書
83	秦野金属(株)	売買基本契約書
84	(株)日本スペリア社	売買基本契約書
85	千住金属工業(株)	売買基本契約書

86	株式会社富士産業	業務委託契約書
87	東京電力エナジーパートナー(株)	電気需給契約書
88	東京電力パワーグリッド(株)	受電状態自動伝達装置の設置に関する契約書
89	東京ガス(株)	ガス需給に関する基本契約書
90		ガス需給契約書(大口契約)
91		基準単位料金の取扱いに関する覚書
92		契約年間負荷率及び契約年間取引量の取扱いに関する覚書
93	野村マイクロ・サイエンス(株)	超純水製造装置 保守契約書
94		覚書
95	(株)巴商会	液化酸素受入装置使用貸借契約書
96	医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院 つくばトータルヘルスプラザ	産業医委託契約書
97	茨城県知事	県西広域工業用水道事業の実施に関する契約書
98	三菱電機ビルソリューションズ株式会社	エレベーターリモートメンテナンス基本契約書(No.1号機)
99		エレベーターリモートメンテナンス基本契約書(No.2号機)
100	(株)ダイセキ	産業廃棄物処理委託契約書(処分):脱水汚泥・廃油
101		産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬):脱水汚泥・廃油
102	(有)スズキクリーンサービス	産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬):脱水汚泥
103	新日本環境整備(株)	産業廃棄物処収集・運搬及び処分委託契約書(処分・収集運搬): 汚泥・廃アルカリ
104	(株)鮫川リサイクル	産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書(収集運搬):汚泥
105	(株)友和环境第三工場	産業廃棄物処分委託契約書(処分):脱水汚泥
106	(株)結南クリーンセンター	産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書(収集運搬):脱水汚泥
107	(有)酒寄資源センター	産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬):廃プラ・ガラス・蛍光灯
108		産業廃棄物収集運搬処理委託契約書(収集運搬):水銀使用製品
109	丸源起業(株)	産業廃棄物処分委託基本契約書(処分):廃プラ・ガラス・蛍光灯
110	(株)ウム・ヴェルト・ジャパン	産業廃棄物処分委託契約書(処分):水銀使用製品
111	栃木ハイトラスト(株)	産業廃棄物処理委託契約書(処分):CVD粉体
112	(株)ダイセキ	産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬)
113	クリーンテックシオガイ(株)	産業廃棄物処分委託契約書(処分):複合材
114	(株)ヤマゲン	産業廃棄物処分委託基本契約書(処分):木くず
115	(有)酒寄資源センター	産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書(収集運搬):木くず
116	(株)エスアール	産業廃棄物処分委託契約書(処分):電池
117	(株)ケイ・エム環境	産業廃棄物収集・運搬委託契約書(収集運搬):電池
118	ジャパンウェイスト株式会社	産業廃棄物処理委託契約書(処分・収集運搬):薬品ボトル等
119	(有)岸興業	産業廃棄物処理委託契約書(処分):レジスト廃液
120	三和油化工業(株)	産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬):レジスト廃液
121	サンワリ्यूター(株)	産業廃棄物処分委託契約書(処分):電池
122	東京鐵鋼(株)	産業廃棄物処分委託契約書(処分):RCF
123	東日本エア・ウォーター物流(株)	産業廃棄物処分委託契約書(収集運搬):RCF

124	(株)日昇つくば	事業系一般廃棄物収集運搬業務委託契約書（収集運搬）：一般廃棄物
125	株式会社相新日本環境調査センター	産業廃棄物処収集・運搬及び処分委託契約書(処分・収集運搬)：汚泥・廃アルカリ



別紙 2 承継会社の成立の日における貸借対照表の内容

(単位:百万円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
現預金	25	買掛債務	0
売掛債権	0	未払金等	0
棚卸資産	0	流動負債計	0
流動資産計	25	固定負債計	0
有形固定資産	0	資本金	25
無形資産等	0	資本剰余金	0
固定資産計	0	純資産計	25
資産合計	25	負債・純資産合計	25